

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于 2026 年度向银行及其他融资机构申请综合 授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司（含子公司）向银行及其他融资机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）。上述授信总额度不等于公司实际融资金额，最终以银行及其他融资机构实际审批的授信额度为准，实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自公司相关董事会审议通过之日起一年内。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日